

**OMNIMATE Housing – serie CH20M
CH20M FE 12-67 1.5SN RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**FE-kontakt****Funktionssäkerhet – antingen helt integrerad eller enkelt monterbar**

Tillvalet "CH20M FE"-anslutning skyddar ditt system optimalt med en montageskenekontakt för funktionsjorden.

- Funktionsjordskontakten, förkonfektionerad i 6 mm-kapslingen, tillåter permanent och pålitlig anslutning av elektroniska skärmar för den elektroniska kretsen till montageskenan (t.ex. "CH20M6 BP 4P-4P FE BK", 1 164650000)
- En funktionsjordskontakt, som kan hanteras helt automatiskt med hjälp av Reflow-metoden, tillsammans med hankontakterna och en valfri busskontakt, finns för kapslingar från 12,5 till 67,5 mm. Kretskortets läge i kapslingen anger stiftlängden 1,5 mm/3,2 mm

Allmänna beställningsdata

Typ	CH20M FE 12-67 1.5SN RL
Art.nr.	1189370000
Artikelbeteckning	Elektronikkapsling, Tillbehör, THT/THR lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 1, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, Tape
GTIN (EAN)	4032248972715
Frp	750 Stück
Produktparametrar	UL:
Förpackning	Tape

**OMNIMATE Housing – serie CH20M
CH20M FE 12-67 1.5SN RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	0,482 g
-----------	---------

Materialdata

Kontaktyta	förtennad
------------	-----------

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984
------------------------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002637	ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-18-92-90
eClass 7.1	27-18-92-90	eClass 8.1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-27-90	eClass 9.1	27-18-27-90

Anmärkningar

Anmärkningar

IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
-----------------	---

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Teknikuppgifter Data	STEP

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.